

证券代码：300964

证券简称：本川智能

债券代码：123268

债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华金证券股份有限公司研究所 启赋私募基金管理有限公司
时间	2026年6月25日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	1、财务负责人、董事会秘书董超先生； 2、研发总监张建波先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、公司 CIPB 项目的技术原理、核心优势及应用场景是什么？市场前景如何？</p> <p>答：CIPB（芯片埋入功率板）是新一代电力电子技术，通过将结构件、元件与 PCB 重塑集成，实现芯片与基板的一体化封装，解决传统叠层架构体积大、散热差、寄生电感高等痛点。</p> <p>（1）核心技术优势</p> <p>电气性能提升：相比传统模块，寄生电感降低 90%以上，开关损耗显著降低，电源转换效率大幅提升。</p> <p>热管理与可靠性：通过背面直贴高导热层，结温降低 15-20 度，支持 200 度高温运行；功率循环次数超过 10 万次，是传统方案的 3-10 倍。</p> <p>高集成度与小体积：省去独立驱动板和连接端子，面积缩小</p>

30%-50%，功率密度提升 2-3 倍。

成本优势明显：通过简化结构和工艺，预计比传统方案降低成本 20%-30%。

(2) 核心应用场景

AI 服务器电源：适配超高功率应用场景，效率提升 3%-5%，体积缩小 50%。

新能源汽车：助力逆变器实现 1200KW 高功率密度，体积缩小 1/4。

储能光伏：开关损耗降低 50%，整机效率提升 2%-4%，寿命提升 3 倍。

机器人：关节驱动体积缩小 60%-80%，响应速度提升 50% 以上。

(3) 市场前景

CIPB 下游应用市场规模广阔，可应用于 AI 服务器超高功率电源方案、新能源汽车 800V/1200V 高压平台等。

2、公司当前营收情况如何？

答：2025 年营收同比增长 46.94%，归母净利润同比增长 33.74%，综合毛利率约 17.13%；2026 年 Q1 营收同比增长 38.06%，综合毛利率约 19.26%，资产负债率较低，经营状况稳健，为长期战略扩张提供坚实保障。公司营收规模持续扩大，主要得益于高端产品量价齐升及不断优化产品结构和客户结构，订单景气度较高。

3、公司 CIPB 项目的商业化进展情况如何，预期什么时候能够量产？相关生产设备是自研的还是外购？

答：公司正在对 CIPB 项目生产厂房进行升级改造和布局专用生产线。目前，多家客户已完成多版送样，并进入小批量试产阶段，预计明年一季度专用厂房投入运营后开始量产。公司相关生产设备均按需求定制化采购。

4、企业实控人有计划减持吗？

	<p>答：截至目前，公司实际控制人暂无减持的相关安排。后续如有相关安排，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>5、请问 CIPB 在 VPD 垂直供电场景下有什么具体应用？</p> <p>答：VPD 垂直供电对 GPU 背部基板有超薄、强散热、大电流、高压绝缘、长寿命五大严苛要求；CIPB 芯片埋入功率板将功率芯片埋入基板内部、取消焊线，兼具散热优化、模块小型化、高可靠等优势，是适配 VPD 规模化量产的主流标准化配套方案，我们相信未来行业大规模出货时二者将深度绑定普及。</p> <p>6、请问布局 CIPB 产品存在哪些行业进入壁垒？</p> <p>答：（1）工艺壁垒（难度最高、耗时最长）</p> <p>CIPB 生产需同步解决高温压合板材翘曲变形、高压工况绝缘击穿、微米级微孔填铜无空洞、芯片埋入应力平衡等多项难题；整套生产参数需要数年、上万次调试积累，仅采购设备无法直接实现量产。</p> <p>（2）路线壁垒（技术赛道完全割裂）</p> <p>多数传统 PCB 企业研发的埋入工艺主攻车载低压电控，对应的电压等级、工艺体系、设计标准和 CIPB 完全不通用，二者属于两条独立技术赛道，低压埋入成熟技术无法平移复用。</p> <p>（3）客户认证壁垒（核心护城河）</p> <p>相关认证周期长达 18-24 个月，需完成高低温、老化、湿度、高压、长期可靠性等全套测试；客户方案定型、试样验证通过后，不会轻易更换基板厂商，更换供应商需要重新走完全套认证，容易错失新品迭代窗口，也让赛道短期竞争格局相对稳定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 25 日